

杭州士兰微电子股份有限公司

2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上

● 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 32,980.17 万元到 39,576.20 万元；预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 28,602.64 万元到 35,198.67 万元。

一、 本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 32,980.17 万元到 39,576.20 万元，与上年同期相比，将增加 10,993.39 万元到 17,589.42 万元，同比增加 50%到 80%。

2、预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 28,602.64 万元到 35,198.67 万元，与上年同期相比，将增加 3,432.61 万元到 10,028.64 万元，同比增加 13.64 %到 39.84 %。

（三）本期预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：21,986.78 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：25,170.03 万元。

（二）每股收益：0.13 元。

三、本期业绩变动的主要原因

（一）报告期内，公司深入实施“一体化”战略。一方面，公司通过保持高强度的研发投入，持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、汽车、新能源、工业、通讯和算力等高门槛市场的拓展力度，公司总体营收保持了较快的增长势头。另一方面，公司通过积极扩大产出、采取各项降本增效举措，有效应对外部激烈市场竞争，使得公司产品综合毛利率与 2024 年相比保持了基本稳定。

（二）报告期内，公司子公司士兰集成 5、6 吋芯片生产线、子公司士兰集昕 8 吋芯片生产线、重要参股企业士兰集科 12 吋芯片生产线均实现满负荷生产。士兰集成、士兰集昕、士兰集科三家公司的盈利水平均较 2024 年有所提升。

（三）报告期内，公司子公司成都士兰、成都集佳功率模块和功率器件封装生产线均保持稳定生产。成都士兰（含成都集佳）的盈利水平较 2024 年保持相对稳定。

（四）报告期内，公司子公司士兰明镓经营性亏损较 2024 年有所增加，其亏损增加的主要原因是：

1、士兰明镓 6 吋 SiC 功率器件芯片生产线处于生产爬坡期，由于前期产出相对较少，生产成本中分摊的固定资产折旧金额较高，且前期采购的原材料主材成本较高，而 SiC 芯片市场价格下降幅度较大，导致 SiC 功率器件芯片生产线经营性亏损较大。公司已开发了多种规格的 SiC 功率器件芯片，可以满足汽车、新能源、工业、家电等多样性的需求。2025 年下半年，士兰明镓 SiC 功率器件芯片生产线产出已经逐步增加，预计 2026 年将实现满产。

2、士兰明镓 LED 芯片生产线产能利用率较 2024 年已有明显提升，产销量也有较大幅度的上升，并且随着植物照明、安防监控、Mini 显示屏芯片上量，产品结构进一步优化，2025 年全年经营性亏损较 2024 年有所减少。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日